会社の概況（平成29年３月31日現在）

商号	信越ポリマー株式会社 (Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd.)
本社所在地	東京都千代田区神田須田町一丁目９番地
設立年月日	昭和35年９月15日
資本金	11,635,953,759円
従業員数	607名（連結4,144名）
事業所	
支店・営業所	大阪支店、名古屋支店、福岡支店、仙台営業所、広島営業所、札幌営業所
工場	東京工場、児玉工場（以上、埼玉県）、南陽工場（山口県）
株式の状況	
発行可能株式総数	320,000,000株
発行済株式総数	82,623,376株
株主数	9,931名

株主の皆様の声をお聞かせください

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、
アンケートを実施いたします。お手数ではございますが、
アンケートへのご協力をお願いいたします。

下記ＵＲＬにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示されるアンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

http://www.e-kabunushi.com
アクセスコード 7970

いいかぶ　検索

空メールによりURL自動返信
kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。(タイトル、本文は無記入)
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

●アンケート実施期間は、本書がお手元に到着してから約2ヶ月間です。

ご回答いただいた方の中から抽選で薄謝（図書カード500円）を進呈させていただきます

e-株主リサーチ

※本アンケートは、株式会社 a2media（エー・ツー・メディア）の提供する「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。
（株式会社 a2mediaについての詳細http://www.a2media.co.jp）
※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

●アンケートのお問い合わせ
「e-株主リサーチ事務局」
TEL：03-5777-3900（平日 10:00～17:30）
MAIL：info@e-kabunushi.com

株主メモ

事業年度	毎年４月１日から翌年３月31日まで
剰余金の配当基準日	３月31日（中間配当を行う場合は９月30日）
定時株主総会	毎年６月
単元株式数	100株
株主名簿管理人 特別口座管理機関	東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社
公告方法	電子公告（http://www.shinpoly.co.jp/） なお、やむを得ない事由によって、電子公告によることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。

株式に関するお手続

	証券会社等に口座をお持ちの場合	証券会社等に口座をお持ちでない場合（特別口座の場合）
郵便物送付先	お取引の証券会社等になります。	〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電話お問合せ先		フリーダイヤル　0120-288-324 （土・日・祝日を除く 9：00～17：00）
各種手続お取扱店（住所変更、株主配当金受取方法の変更等）		みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 ＊トラストラウンジでは、お取扱できませんのでご了承ください。 みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店 プラネットブース（株式会社みずほ銀行内の店舗）でもお取扱致します。
未払配当金のお支払	みずほ信託銀行株式会社　本店及び全国各支店 株式会社みずほ銀行　本店及び全国各支店 （みずほ証券株式会社では、取次のみとなります。）	
ご注意	支払明細発行については、右の「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話お問合せ先・各種手続お取扱店をご利用ください。	特別口座では、単元未満株式の買取・買増以外の株式売買はできません。証券会社等に口座を開設し、株式の振替手続を行っていただく必要があります。

単元未満株式買増・買取のご案内

当社では、単元未満株式（１株から99株まで）の買増制度・買取制度を導入しておりますので、ご利用ください。
お手続の詳細は、上記記載のお取扱店にお問い合せください。

信越ポリマー株式会社
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町１-９
電話　(03) 5289-3712
ホームページアドレス　http://www.shinpoly.co.jp/

UD FONT 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

Shin-Etsu
信越ポリマー株式会社

第57期 報告書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

証券コード:7970

株主の皆様へ

代表取締役社長　小野　義昭

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、ここに、当社グループの第57期連結会計年度（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）の事業の概況等をご報告申しあげます。

当連結会計年度の業績は、売上高739億79百万円（前期比1.4％減）、営業利益55億11百万円（前期比34.4％増）、経常利益59億34百万円（前期比30.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益42億30百万円（前期比34.2％増）となりました。

当期の期末配当金につきましては、業績及び今後の事業展開等を総合的に勘案し、１株につき６円とさせていただきました。

これにより、中間配当金６円を加えた年間配当金は、１株につき12円となり、前期と比較して３円の増配となります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますよう心からお願い申しあげます。

平成29年６月

事業の概況

当連結会計年度における世界経済は、米国では個人消費が底堅く推移するなど堅調な景況感が続き、欧州では金融市場で一時的な混乱がありましたが、景気は緩やかに回復してきました。また、アジアでは中国の景気減速が続きましたものの、ASEAN諸国の景気には持ち直しが見られました。

日本経済は、雇用・所得環境が堅調で、期後半から、円安・ドル高基調に転じたことを受けて、輸出関連企業を中心に収益改善に向かう傾向が見られ、景気は緩やかな回復基調となりました。

当社グループ関連の事業環境につきましては、円高などの影響を受けましたものの、自動車関連分野では世界的に安定した生産が続き、半導体関連分野の需要も高水準で推移しました。

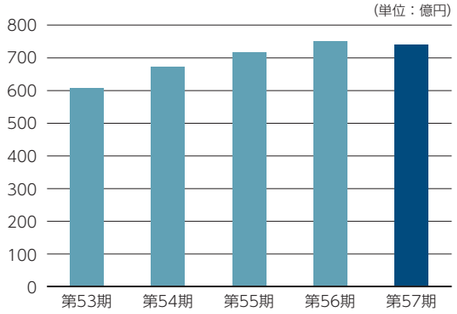
このような状況のもと、当社グループは、国内外で主力成長製品の拡販に注力した営業活動を継続的に展開し、また、生産拠点における増築を含めた生産能力の増強、生産性及び品質の向上などを目的とした設備投資を積極的に進めてまいりました。更に、期初に再編発足させた開発本部と生産本部は、営業本部と三位一体の事業運営を徹底し、事業環境の変化に即応することに努めてまいりました。

今後につきましては、当社グループの事業領域である電気・電子機器、半導体業界等では、お客様の生産動向、競合他社との競争激化など事業環境の先行きが不透明であり、予断を許さない状況にありますが、世界市場の需要の伸びを的確にとらえた販売活動と、最適地生産を徹底して、グローバルな事業展開を加速させてまいります。

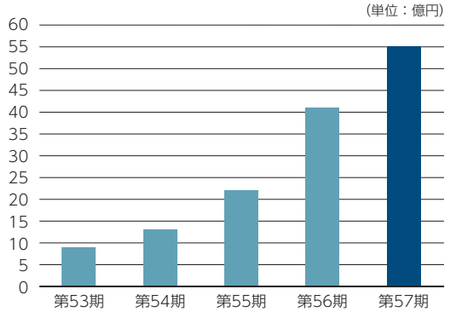
当社グループは、安全第一に、地球環境保全、コンプライアンスなどの企業の社会的責任を念頭に行動するとともに、コーポレートガバナンスの充実及びリスク管理に万全を期し、企業体質の強化と企業価値の向上に努めてまいります。

業績ハイライト（連結）

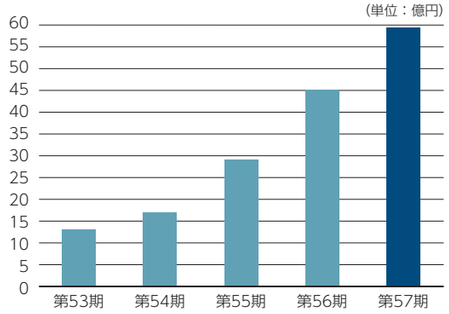
売上高



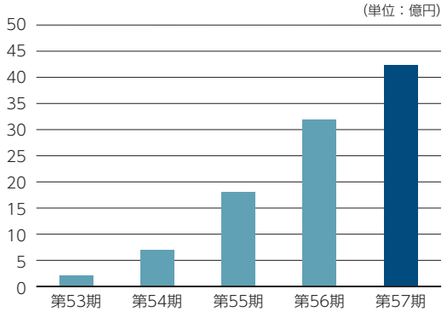
営業利益



経常利益



親会社株主に帰属する当期純利益



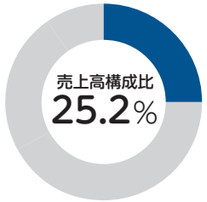
電子デバイス事業

売上高
18,644百万円
（前期比6.5％減）

円高の影響などにより減収減益

自動車関連入力デバイスの出荷は好調でしたが、円高の影響などにより、全体として売上げ、利益とも前年度を下回りました。

この結果、当事業の売上高は186億44百万円（前期比6.5％減）、営業利益は11億82百万円（前期比6.8％減）となりました。



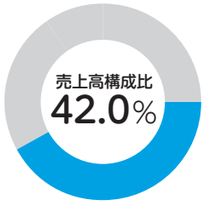
精密成形品事業

売上高
31,074百万円
（前期比2.3％増）

半導体関連容器が大きく伸長して増収増益

半導体関連容器の出荷が好調に推移し、全体として売上げは前年度を上回り、利益は大幅に伸長しました。

この結果、当事業の売上高は310億74百万円（前期比2.3％増）、営業利益は45億４百万円（前期比24.7％増）となりました。



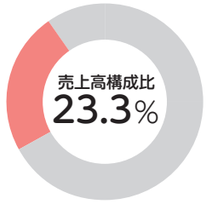
住環境・生活資材事業

売上高
17,269百万円
（前期比5.1％減）

構造改革進行中ながら減収減益

不採算事業の整理に取り組みましたが、塩ビ関連製品の国内市場での需要低迷と価格競争により全体として売上げは前年度を下回り、利益の改善は進みませんでした。

この結果、当事業の売上高は172億69百万円（前期比5.1％減）、営業損失は１億16百万円（前期は39百万円の損失）となりました。



その他

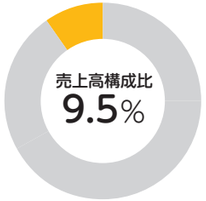
売上高
6,991百万円
（前期比7.2％増）

工事関連の安定受注により増収

工事関連では、首都圏を中心に商業施設の新築・改装物件の受注を安定して獲得し、全体として、売上げは前年度を上回りました。

なお、左記各事業に含まれない新規事業開発関連をその他に含めております。

この結果、その他の売上高は69億91百万円（前期比7.2％増）、営業損失は58百万円（前期は７億40百万円の損失）となりました。



連結財務諸表（要約）

単位：百万円（百万円未満切捨表示）

連結貸借対照表

科　目	前連結会計年度	当連結会計年度
（資産の部）		
流動資産	69,953	73,178
固定資産	22,892	22,882
資産合計	92,845	96,061
（負債の部）		
流動負債	20,035	21,628
固定負債	1,556	1,542
負債合計	21,592	23,171
純資産合計	71,253	72,890
負債・純資産合計	92,845	96,061

連結損益計算書

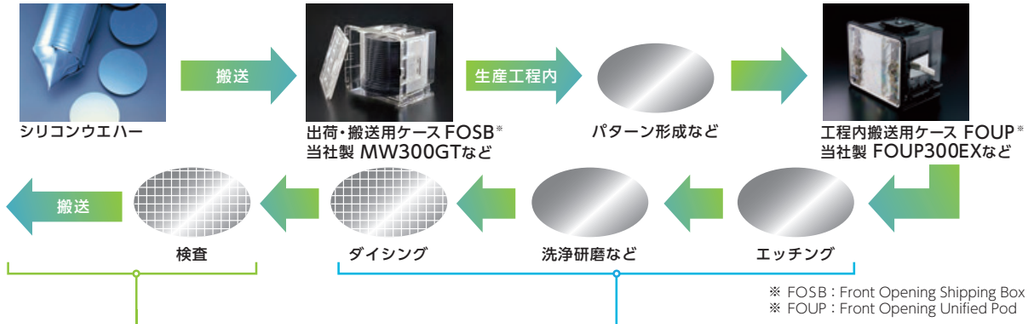
科　目	前連結会計期間	当連結会計期間
売上高	75,039	73,979
営業利益	4,101	5,511
経常利益	4,532	5,934
親会社株主に帰属する当期純利益	3,151	4,230

連結キャッシュ・フロー計算書

科　目	前連結会計期間	当連結会計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,682	7,278
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,768	△ 1,843
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,179	△ 789
現金及び現金同等物の期末残高	35,377	38,981

会社紹介

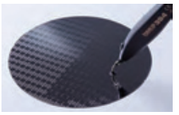
粘着の新たな技術で新市場を開拓



※ FOSB：Front Opening Shipping Box
※ FOUP：Front Opening Unified Pod

半導体チップ

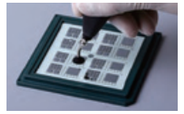
Shin-Etsu スティッキーキャリア



スティッキーキャリアは繰り返し使用可能な半導体プロセス治具です。

- 独自のシリコーン材料組成と粘着パターン層の設計で顧客要求に対応
- 使用後に粘着層を除去し、基板の再利用が可能
- FOSB等に収納して、多数の半導体チップを一括して搬送することが可能

Shin-Etsu スティッキートレイ

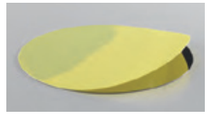


スティッキートレイは自己粘着フィルム技術を利用した粘着固定式の搬送容器です。

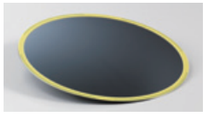
- 振動に強く、脆弱な部品にダメージを与えずに輸送が可能
- 当社独自の剥離機構により、部品の安定的なピックアップが可能
- SEMI規格に準拠（G97-0116「Specification of Adhesive tray used for thin chip handling」）（一部製品を除く）

半導体・ウエハー

Shin-Etsu TWSS ディスクタイプ



Shin-Etsu TWSS リングタイプ



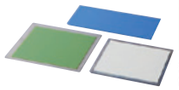
TWSS※は従来の接着剤＆溶剤によるウェットプロセスを、耐熱基材と粘着性エラストマーによりドライプロセス化を実現した、全く新しい発想により開発した半導体プロセス治具です。

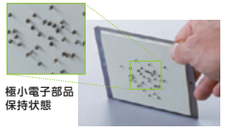
- エラストマーの自己粘着性を利用、接着剤とこれを塗布するためのスピンコータ、また溶剤剥離プロセス装置などが不要
- ウエハーと貼り合せるだけで、治具に密着。また、基材をしならせることで、小さな負荷で治具のリリースが可能
- デバイス洗浄、成膜プロセス、フォトプロセス、レーザーダイシング、搬送用途など薄ウエハーのプロセスハンドリングに

※ TWSS：Thin-Wafer-Support-System

電子部品

粘着プレートHSP





極小電子部品保持状態

粘着プレートHSPは電子部品を粘着力で保持・搬送する治具です。

- ベースのエラストマーは、耐熱性、耐薬品性などに優れた粘着性シリコーンゴム
- ゴム硬度は20～40度
- 粘着力は任意設定が可能
- アルミプレート、SUSプレート、ガラエポなどの基材への貼り付けや一体成形で供給
- 厚みは基材が0.3㎜以上、シリコーンゴムが0.5㎜～5㎜で対応が可能
- サイズは300㎜×300㎜まで
- 着色（調色）も可能

≪トピックス≫

半導体市場拡大に対応するため、糸魚川工場を増築

当社は、半導体関連市場の拡大を見据え、主にシリコンウエハーの搬送用容器であるウエハーケースを生産している糸魚川工場（新潟県糸魚川市）の生産能力増強のために、既存工場を増築することを決定しました。これにより、既存事業である300mmや200mmウエハー容器の需要増加に備え、より一層の安定供給体制を確立します。また、半導体関連の新規事業のために、市場の需要動向に合わせて積極的な設備投資を行う予定です。増築する建屋は2018年初めをめどに工事着工し、同年秋ごろの完成を予定しています。

糸魚川工場外観

工場増築予定地：新潟県糸魚川市大和川地区
増築建屋延床面積：8,000㎡
投資予定金額：34億円

また、今年４月からは、半導体製造工程内で使用される『液体濾過フィルター』事業にも本格的に参入し、今後も半導体関連事業の拡大を目指していきます。

Shin-Etsu Polymer India Pvt. Ltd.がデリー支店を設立

当社の100%子会社であるShin-Etsu Polymer India Pvt. Ltd.がインド北部のデリー近郊に支店を開設し、2017年2月1日から業務を開始しました。

同社は、2007年10月、インド共和国南部タミル･ナードゥ州にシリコーン加工品の生産拠点として設立され、インド国内だけでなく、欧州向けの自動車部品を生産・販売しています。

インド国内にて自動車ビジネスが拡大する中で、引合、受注が増えているデリー近郊グルグラム（旧名称：グルガオン）地域に営業拠点を置くことで、顧客密着体制を強化し、迅速な引合対応、顧客開拓に注力しています。

Shin-Etsu Polymer India Pvt. Ltd.デリー支店が入居しているビル

■支店の概要
商　　号：Shin-Etsu Polymer India Pvt. Ltd.
　　Delhi Branch
所　在　地：3rd Floor, Building No.9-A, DLF Cyber City Phase-3,
　　Gurugram , Haryana 122002. India
電話番号：+91-12-4454-5000
ＦＡＸ番号：+91-12-4454-5001